

## ◆RoHS規制物質への対応 / Conforming to RoHS Directive

品種 TYPE	アルミ電解コンデンサ Aluminum Electrolytic Capacitors				フィルムコンデンサ Film Capacitors	
	チップタイプ SMD	リード線タイプ Lead Wire	スナップインタイプ Snap-in	ネジ端子タイプ Screw terminal	メタライズドタイプ Metallized	箔電極タイプ Foil
RoHS指令 RoHS Compliance	対応済/Complied					
鉛 Lead	含有せず / Not contain					
端子材質 Terminal material	(~φ10) Fe/Cu/Sn-0.5Bi (φ12.5~) Fe/Cu/Sn	Fe/Cu/Sn		アルミニウム Aluminum	Fe/Cu/Sn or Cu/Sn	Fe/Cu/Sn
はんだ耐熱性 Resistance to Soldering heat	「リフロー許容条件」 を参照ください。 Please find "Reflow Soldering Condition"		フローはんだ付け260℃ 260℃ Flow Soldering	はんだ付け対象外 Not applicable	「はんだ付け作業」を参照ください。 Please find "Soldering Operation"	
カドミウム Cadmium	含有せず / Not contain					
水銀 Mercury	含有せず / Not contain					
六価クロム Chrome(VI)	含有せず / Not contain (*1)					
PBB PBDE	含有せず / Not contain					
DEHP, BBP DBP, DIBP	含有せず / Not contain					
RoHS対応品識別 Identification for RoHS Compliance Parts	内装・外装ラベルにRoHS Complianceを表記 Add "RoHS Compliance" marking on inner and outer carton lable					

品種 TYPE	導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ Conductive Polymer Aluminum solid electrolytic Capacitors		薄膜高分子積層コンデンサ Polymer Multi-Layer Capacitors		電気二重層キャパシタ Electric Double Layer Capacitors
	PZ-CAP		チップタイプ SMD	リード線タイプ Lead Wire	リード線タイプ Lead Wire
RoHS指令 RoHS Compliance	対応済/Complied				
鉛 Lead	含有せず / Not contain				
端子材質 Terminal material	リード Lead	Fe/Cu/Sn	Brass/Cu/Sn or Brass/Cu paste/Sn	Fe/Cu/Sn	Fe/Cu/Sn
	チップ SMD	Fe/Cu/Sn-0.5Bi			
はんだ耐熱性 Resistance to Soldering heat	リード Lead	フローはんだ付け260℃ 260℃ Flow Soldering	260℃リフロー/フロー	フローはんだ付け260℃	フローはんだ付け260℃
	チップ SMD	リフロー Reflow (*2)	260℃ Reflow/Flow (*3)	260℃ Flow Soldering	260℃ Flow Soldering
カドミウム Cadmium	含有せず / Not contain				
水銀 Mercury	含有せず / Not contain				
六価クロム Chrome(VI)	含有せず / Not contain (*1)				
PBB PBDE	含有せず / Not contain				
DEHP, BBP DBP, DIBP	含有せず / Not contain				
RoHS対応品識別 Identification for RoHS Compliance Parts	内装・外装ラベルにRoHS Complianceを表記 Add "RoHS Compliance" marking on inner and outer carton lable				

\*1:ネジ端子タイプ取付バンド:三価クロムメッキ/Band of Screw terminal type:Chromium(III)

\*2:詳細は「リフロー許容条件」を参照ください。/Please find "Reflow Soldering Condition".

\*3:STシリーズはリフロー実装専用です。/ST series shall be used in only reflow method.

## ◆欧州REACH規則への適合について / Regarding compliance to European REACH Regulation

RIP3.8TGD(Technical Guidance Document: 2008/5/26 公開)の内容に基づき、弊社製電子部品は「意図的放出のない成形物」であり、欧州REACH規則第7条1項「登録」の適用外です。

According to the content of RIP3.8TGD(Technical Guidance Document) which is published on 26 May 2008, our electronic components are "articles without any intended release." Therefore the are not applicable for "Registration"for European REACH Regulation Article 7(1).